

江苏省半导体行业协会

苏半协字（2021）36号

关于发布《晶圆级扇外型封装外形尺寸》 等三项团体标准的通知

各有关单位：

根据《江苏省半导体行业协会团体标准管理办法》的规定，批准以下3项标准为江苏省半导体行业协会团体标准：

- 1、晶圆级扇外型封装外形尺寸（编号：T/JSSIA 0006—2021）；
- 2、堆叠封装上封装体外形尺寸（编号：T/JSSIA 0007—2021）；
- 3、堆叠封装下封装体外形尺寸（编号：T/JSSIA 0008—2021）。

上述标准2021年11月10日发布，2021年11月15日起实施。

特此通知

江苏省半导体行业协会
二〇二一年十一月十日

